

ICEPT 2026 整体日程

8月5日		会场 1		会场 2		会场 3		会场 4	
	08:30-12:05	专业培训课程 1-2		专业培训课程 3-4		专业培训课程 5-6		专业培训课程 7-8	
	13:00-16:15	特别专题 1-2		特别专题 3-4		特别专题 5-6		特别专题 7-8	
	20:00-22:00	伊帕思杯 • ICEPT 2026 南北足球友谊赛							
8月6日	08:30-12:10	大会报告 1-5							
		会场 1	会场 2	会场 3	会场 4	会场 5	会场 6	会场 7	会场 8
	13:00-15:10	专题 1	专题 2	专题 3	专题 4	专题 5	专题 6	专题 7	专题 8
	15:10-15:50	墙报展示 A							
	15:50-18:00	专题 9	专题 10	专题 11	专题 12	专题 13	专题 14	专题 15	专题 16
	18:30-21:00	欢迎晚宴							
8月7日		会场 1	会场 2	会场 3	会场 4	会场 5	会场 6	会场 7	会场 8
	08:30-10:10	专题 17	专题 18	专题 19	专题 20	专题 21	专题 22	专题 23	专题 24
	10:10-10:50	墙报展示 B							
	10:50-12:30	专题 25	专题 26	专题 27	专题 28	专题 29	专题 30	专题 31	专题 32
	13:30-15:30	大会报告 6-9							
	15:30-16:10	墙报展示 C							
	16:10-18:10	大会报告 10-13							
	结束								



The 27th International Conference on Electronic Packaging Technology

August 5-7th, Xi'an China

8月5日 上午 --- 专业培训课程				
时间	会场 1	会场 2	会场 3	会场 4
8:30-10:10	专业培训课程 1 - 《驱动兆瓦级 AI 时代：下一代封装》	专业培训课程 3 - 《先进系统封装与焊料互连》	专业培训课程 5 - 《铜 - 铜混合键合与硅光子共封装光学技术》	专业培训课程 7 - 《面向光链路的光子器件与封装技术》
	陈光雄 先生 中国台湾日月光中坜厂工程发展中心资深副总	葛维沪 博士; 马莒生 教授 美国 Pacrim 技术公司创始人; 中国清华大学教授	刘汉诚 博士 中国台湾欣兴电子股份有限公司首席科学家	Torsten Wipiejewski 博士 德国 Huawei Technologies Dueseldorf GmbH 总监
10:10-10:25	休息			
10:25-12:05	专业培训课程 2 - 《电子封装中的纳米材料和高分子复合材料》	专业培训课程 4 - 《半导体封装中的高可靠性焊接》	专业培训课程 6 - 《晶圆键合与混合键合技术：从原理到前沿应用》	专业培训课程 8 - 《先进电子封装应力应变分析实验方法》
	李 卓 教授 中国复旦大学教授	李宁成 博士 中国炫纯科技有限公司创始人	王晨曦 教授 中国哈尔滨工业大学教授	Jeffery Suhling 教授 美国奥本大学教授
12:05-13:00	休息			



8月5日 下午 --- 特别专题				
Time	会场 1	会场 2	会场 3	会场 4
特别专题	专题 1: IEEE-EPS R10 特别专场	专题 3: 先进封装与系统集成 EDA 技术应用论坛 	专题 5: 混合键合技术专场	专题 7: 数字光刻技术论坛: 先进封装与微纳器件 
主席	王 谦 教授, IEEE-EPS 北京分会主席	杨 军 教授, 东南大学	叶五毛 博士, 拓荆科技股份有限公司	梅文辉 博士, 芯碁微装
13:00-14:25	Jeffery Suhling 教授, IEEE EPS 主席, 美国奥本大学教授, IEEE Fellow Shaw Fong Wong 博士, IEEE EPS R10 主席	开场致辞	开场致辞	开场致辞 王启东 博士, 中科院微电子所封装中心主任, 集成电路制造技术全国重点实验室副主任
	《前路征程: 实体人工智能规模化发展》 Eu Poh Leng 博士, 荷兰恩智浦半导体委外封装高级总监	《连接 PCB 与先进封装: 迈向封装感知设计的旅程》 贾 亮 先生, 中国华讯科技半导体事业部总监	《面向先进半导体制造的可编程晶圆挠曲控制的低变形晶圆键合技术》 龚 里 博士, 苏斯贸易(上海)有限公司总经理	《数字光刻发展与趋势》 梅文辉 博士, 芯碁微装首席科学家
	《面向高性能计算与 AI 应用的 PLP 新一轮技术浪潮》 Tanja Braun 博士, 德国弗劳恩霍夫可靠性和微集成研究所部	《先进封装仿真设计解决方案及挑战》 吕广超 博士, 中国华进半导体封装先导技术研发中心有限公司资深研	《AI 时代驱动下的键合技术发展趋势》 谭昊天 博士, 中国芯慧联芯(江苏)科技有限公司资深市场战略	《数字光刻赋能 AI 芯片与先进封装——国产装备的创新与突破》 蔡志鸿 先生, 芯碁微装产品经理



	门主任 《人工智能市场快速演进对先进封装供应链的影响》 Yu-Po, Wang 博士, 美国 Prismark 首席顾问	发工程师 《STCO 牵引的 3DIC 设计方法学趋势及产业实践》 刘晓明 博士, 中国北京华大九天科技股份有限公司产品总监	规划专家 《技术融合赋能 AI 时代》 松村贤人 先生, Tokyo Electron 高级总监	《先进封装：从微机电系统到纳米制造》 刘泽文 教授, 清华大学集成电路学院教授
14:25-14:35	茶歇&展览交流			
特别专题	专题 2：EPS R10 特别专场	专题 4：先进封装与系统集成 EDA 技术应用论坛	专题 6：混合键合技术专场	专题 8：数字光刻技术论坛：先进封装与微纳器件
主席	叶怀宇 副教授, IEEE-EPS 广州分会副主席	刘晓明 博士, 北京华大九天科技股份有限公司	王启东 博士, 中国科学院微电子研究所	梅文辉 博士, 芯碁微装
14:35-16:15	《高速传输封装技术》 Kazuyuki Nakagawa 先生, 瑞萨电子株式会社封装与装配事业部 高级经理	《AI 时代的物理感知逻辑综合》 朱可人 博士, 中国复旦大学助理教授	《面向混合键合的表面波激发等离子体下游区域等离子体活化》 森川泰弘 博士, 日本爱发科株式会社技术经理	《数字光刻助力科研多场景应用方案》 陈伟龙 先生, 芯碁微装产品经理
	《QULET：面向超导量子计算的量子芯粒集成技术》 俞杰勋 博士, 清华大学	《面向芯片全生命周期的结构可靠性 EDA 协同仿真与优化：芯片设计、封装、系统集成与可靠性验证》 程 健 先生, 中国长电科技专家工程师	《下一代 3D 封装前沿：从设备视角看 Die-to-Wafer 混合键合面临的挑战》 Jonathan Abdilla 先生, Besi 技术总监	《面向 AI 时代的先进封装》 吴政达 博士, 沛顿科技副总经理



	互动圆桌论坛 主席: 李卓教授, IEEE-EPS 上海分会主席 组员: Jeffery Suhling, Shaw Fong Wong……	《芯粒集成热仿真方法》 徐勤志 博士, 中国科学院微电子研究所研究员	《融合键合与混合键合: 通过半导体技术组合搭配, 优化产品应用性能、功耗与成本》 Thomas Pleschke 先生, 奥地利 EVG 集团业务拓展负责人	互动圆桌论坛 主持人: 梅文辉 博士, 芯碁微装首席科学家
		圆桌讨论	《面向 AI 芯片先进封装的创新设备解决方案》 赵 滨 先生, 中国广东星空科技装备有限公司技术总监	
20:00-22:00	伊帕思杯 • ICEPT 2026 南北足球友谊赛			



8月6日 上午 --- 大会报告	
开幕式	
主席	张国旗 教授，荷兰国家工程院院士，IEEE Fellow
08:30-08:45	开幕致辞
	叶甜春 教授，ICEPT 主席，中国半导体行业协会集成电路分会理事长，IEEE Fellow
	Jeffery Suhling 教授，IEEE EPS 主席，美国奥本大学教授，IEEE Fellow
08:45-09:25	CP Wong 2026 全球电子封装奖
	主席：李世玮 教授，香港科技大学（广州）副校长，IEEE Fellow
大会报告	
09:25-09:55	《用于电子封装应用的应力传感测试芯片》
	Jeffery Suhling 教授 美国奥本大学教授，IEEE EPS 主席，IEEE Fellow
09:55-10:25	《人形机器人与低空经济时代的异质异构集成技术》
	刘胜 教授，中国武汉大学集成电路学院院长，中国科学院院士，IEEE Fellow
10:25-10:40	茶歇与展览交流
主席	李世玮 教授，中国香港科技大学（广州）副校长，IEEE Fellow
10:40-11:10	《Sinterconnects® 平台：双面烧结宽禁带功率模块》
	Ali Roshanghias 博士，奥地利硅实验室（SAL）异构集成技术研究部负责人
11:10-11:40	《玻璃封装及其可靠性》
	刘汉诚 博士，美国欣兴电子公司首席科学家，IEEE Fellow
11:40-12:10	《智算芯片系统先进封装技术应用实践与展望》
	杨道虹 教授，江城实验室主任，湖北大学集成电路学院院长
12:10-13:00	午餐



8月6日 下午---技术专题				
专题	会场1	会场2	会场3	会场4
	专题1	专题2	专题3	专题4
委员会	封装中介层制造技术	焊料合金与金属化材料	封装可靠性分析	互连设计与制造技术
	专题 1-1-先进封装	专题 2-1-封装材料与工艺	专题 3-1-封装设计与建模	专题 4-1-互连技术
主席	吴道伟，西安微电子技术研究所 张翌野，哈尔滨工业大学	杭深，上海交通大学 周磊福，西安交通大学	龙超，西北工业大学 杨道国，桂林电子科技大学	霍永寿，北京理工大学 马书英，华天科技
13:00-13:25 特邀报告	《面向先进互连制造的数字光刻技术零妥协：性能与良率的协同优化》 青木 一也 先生，USHIO INC. AUCC 全球销售事业部、技术市场事业部及客户成功团队 总负责人	《无铍含铜中温无铅焊料-Durafuse® LT 的综述》 张宏阔 博士，铜泰公司 研发总监及首席冶金专家	《Moldex3D先进封装模流分析解决方案及最新技术进展》 沈立轩 博士，科盛科技股份有限公司 研发副处长	《面向异质光电集成的室温表面活化键合技术进展》 多喜川 良 教授，日本九州大学 教授
13:25-15:10 口头报告	<68>《纳米硅通孔（nTSV）刻蚀形貌与金属填充的工艺集成协同优化》	<65>《SiBAC 与 SAC305 焊料高温老化行为对比研究》	<233>《多孔烧结银中的连通性与热传输：统计控制下的二维-三维对比》	<30>《印制电路板铜导线电化学迁移失效中的离子迁移与枝晶生长》
	<763>《SAFO 封装技术》	<75>《无氟 Au-Sn 合金电镀功能添加剂及其在电子封装中的应用》	<525>《基于有限元的板级雷达封装焊球阵列布局优化与疲劳寿命提升》	<94>《面向超高密度互连的等离子体活化分步低温 Ru-Ru 直接键合》
	<236>《面向先进封装的寄生误差自补偿 ZTT 纳米对准装置》	<582>《通过设计-工艺-材料协同优化抑制 eSiF ₄ O 封装焊球空洞》	<72>《侧壁角度与铜层厚度对 TGV 热-机械可靠性的影响》	<114>《纳米硅通孔（TSV）无空洞填充机制研究》
	<683>《高温真空回流过程中半绝缘 SiC 单晶基板分层机制：电-热-机械耦合分析》	<71>《先进半导体封装铜晶粒细化的协同添加剂配方与电化学分析》	<115>《基于仿真的高可靠 SiC 封装研究》	<762>《纳米银浆在（111）取向纳米镍晶膜上的烧结界面形貌演化与接头强度》
	<36>《先进晶圆级封装中的新型中红外激光解键合技术》	<351>《热管理用碳/铜复合材料的显微组织与性能》	<140>《超细线路 RDL 中介层信号完整性的设计、仿真与测试表征》	<164>《基于互锁结构的非 CMP Cu/SiO ₂ 混合键合》
	<725>《紫外激光解键合过程中激光诱导碳残留的形貌与润湿性演化》	<91>《基于双层互连结构的三维紧凑型带通滤波器设计》	<145>《基于注意力深度神经网络的 PCB 导电层均质热-机械性能预测》	<212>《基于激光诱导金属微滴沉积的微凸点阵列打印》
	/	<261>《颗粒尺寸与分布对芯片到晶圆（C2W）混合键合动力学的影响》	<183>《基于 TGV 的 V 波段七阶 LTLR 指叉型带通滤波器设计与优化》	<228>《预干燥工艺辅助 PEG-铜微粒快速低温烧结》
15:10-15:30 墙报展示 A				
专题	会场5	会场6	会场7	会场8
	专题5	专题6	专题7	专题8
委员会	表征分析与可靠性	可靠性测试与建模	功率电子先进材料	光电子集成
	专题 5-1-先进制造	专题 6-1-质量与可靠性	专题 7-1功率电子与能源电子	专题 8-光电子与能源电子
主席	陈志文，武汉大学 江 源，安徽大学	苏昱太，西安西测试技术股份有限公司 范政伟，国防科技大学	叶怀宇，南方科技大学 薛仲明，西安交通大学	龙浩晖，上海交通大学 马涵之，浙江大学
13:00-13:25 特邀报告	《面向AI芯片的先进封装FOPLP与电镀技术的机遇与挑战》 贾照伟 先生，盛美半导体设备（上海）股份有限公司 工艺副总裁	《量产级TGV全工艺流程AOI检测方案》 杨 洋 先生，深圳市华汉伟业科技有限公司 研发总监	《高性能嵌入式功率模块的先进封装解决方案及热机械可靠性研究》 张 靖 博士，上海贺利氏工业技术材料有限公司 研发总监	《AI时代NPDP/CPO光引擎封装及实践探讨》 曹权 博士，武汉飞思灵微电子有限公司（中国信科集团/烽火通信子公司） 光电器件专家
13:25-15:10 口头报告	<709>《源极引线结构与材料对 TO-247-4 封装 SiC MOSFET 电-热-机械性能及电迁移可靠性的影响》	<70>《CNTs-Cu 填充 TSV 阵列的电-热-机械耦合分析与可靠性提升》	<300>《采用自适应分流鳍片结构减小双面冷却功率模块 TIM 厚度与冷却液旁路》	<373>《面向高可靠 CPO 互连的现场可更换气密 VCSEL 光引擎设计》
	<190>《电迁移作用下铜互连中的原子迁移与应力演化》	<288>《基于贡献指数校准损伤累积的 PCB 组件多物理场耦合寿命预测》	<16>《超晶格薄膜热电模块与 β-Ga ₂ O ₃ 肖特基势垒二极管集成及同步制冷发电研究》	<184>《面向光电异构集成的 80Au20Sn 焊凸点热可靠性》
	<326>《SiC 与 Si 中介层晶圆的翘曲分岔行为：基于 RVE 建模的热机械分析》	<334>《布线结构分区等效材料性能的 AI 预测及其在 PCB 翘曲仿真中的应用》	<112>《烧结铜颗粒形貌对显微组织与断裂韧性的影响》	<488>《用于全彩 Micro-LED 显示的激光图案量子点色转换层制备》
	<705>《乙酸调控 Mg-MOF-74 的结构与孔隙特征及其低 k 介质应用》	<532>《面向 BGA 焊点塑性密度小样本预测的物理引导梯度提升方法》	<302>《面向 SiC 功率封装瓶颈的高导热无压铜烧结技术研究》	<599>《面向超高亮度激光照明的先进烧结荧光陶瓷@Cu 转换器》
	<472>《Cu-Sn 纳米复合中间层形成焊料互连的性能表征》	<539>《三维堆叠芯片多物理场仿真的均质等效建模方法》	<639>《从银烧结到铜烧结：面向 SiC 功率模块的全铜烧结互连》	<759>《配体-界面协同调控 PbS 胶体量子点近红外光电探测器的可靠性物理与性能极限》
	<317>《虚拟工厂中的混合认证：面向跨厂制造一致性的数据驱动框架》	<675>《热机械载荷下 16 层 HBM4 混合键合 TSV 结构界面裂纹萌生与扩展的计算表征》	/	<特邀报告>《玻璃基板赋能先进半导体封装：基于机械可靠性的通孔间距设计规则》
	<469>《细间距 RDL 的 XDFOLIO 封装及低成本 TBDB 方案研究》	<707>《热机械载荷下多层 RDL 玻璃基板封装界面分层与玻璃内聚断裂的深入数值研究》		Marin Letz 先生，SCHOTT AG 高级首席科学家
15:10-15:30 墙报展示 A				



8月6日 下午---技术专题				
专题	会场 1	会场 2	会场 3	会场 4
	专题9	专题10	专题11	专题12
委员会	混合键合关键技术	聚合物材料与粘接工艺	热机械耦合建模（一）	面向高功率应用的互连技术
	专题 1-2-先进封装	专题 2-2-封装材料与工艺	专题 3-2-封装设计与建模	专题 4-2-互连技术
主席	王谦，清华大学	李卓，复旦大学	秦红波，桂林电子科技大学	李望云，西南交通大学
	唐昭焕，联合微电子中心有限责任公司	曹亮，安徽大学	刘丰瑞，中国科学院微电子研究所	刘盼，复旦大学
15:50-16:15 特邀报告	《大视场投影光刻、先进封装芯片曝光的技术路径与产业价值》	《超低损耗无玻璃纤维产品在AI高算力时代的技术发展与应用》	《多物理场仿真在半导体先进封装中的应用》	《结构光在透明及非透明材料微纳加工中的创新应用》
	彭博方 博士，上海微芯科技有限公司 创始人	蒋 岳 博士，广东伊帕思新材料科技有限公司 副总经理	何勤铭 博士，COMSOL 中国 应用工程师	Daniel Flamm 先生，TRUMPF SE，Co. KG 光学设计与激光技术首席专家
16:15-18:00 口头报告	<437>《等离子体活化过程中羟基生成的原位 XPS 分析》	<178>《面向先进封装的高性能聚合物介质材料多目标预测与筛选》	<336>《考虑铜布线方向的单斜均质化导电层热建模方法》	<229>《脉冲孔喷射直接沉积 SAC305 凸点的显微组织演化与性能》
	<696>《PVD 沉积 CoaN 钝化层赋能低温 Cu-Cu 直接键合》	<194>《基于多目标机器学习的高性能低 k 互连材料筛选》	<380>《超声热压键合工艺模型构建方法》	<280>《面向多类型基板集成的聚酰亚胺低温异质键合技术》
	<410>《翘曲对 5 μm 间距 D2W 混合键合键位与空洞的影响》	<152>《通过刚性柔性树脂共混提升 FCBGA 阻焊材料可靠性》	<521>《IC 产品电阻焊瞬态热-机械耦合仿真及其对键合线温度循环疲劳寿命的影响》	<312>《2.5D 扇出重构中介层封装中差分高速串行链路低反射串垂直互连的仿真与设计》
	<298>《表面羟基密度对 SiO ₂ 键合行为的影响：分子动力学研究》	<173>《基于位阻氮氧化物的 Si(111) 表面超低 k 薄膜电接枝》	<533>《基于田口-灰色关联分析的功率模块双面烧结低应力结构优化》	<407>《面向氮化硅基板高性能互连的 ZnO-B ₂ O ₃ -SiO ₂ 玻璃粉银浆开发与表征》
	<306>《基于流固耦合分析的涡流式非接触芯片拾取动力学研究》	<348>《面向功率器件的热膨胀系数与热导率可调封装环氧树脂》	<542>《直接晶圆键合面内畸变的主导多物理场因素》	<427>《实现 5 μm 间距 D2W 混合键合：从 CMP 到键合工艺的协同优化》
	<213>《双步激光辅助回流与键合工艺对 Cu 柱界面金属间化合物生长的抑制》	<357>《湿热条件下阻焊层-铜焊膏附附增强：面向先进封装的简易物理共混方法》	<543>《考虑电-热-机械耦合的 Chiplet 封装微凸点接触电阻演化机制》	<448>《用于瞬时液相键合的电镀 Sn-Cu 泡沫制备》
	<589>《面向熔融键合与混合键合空洞及可靠性预测的无量纲方案》	<174>《面向硅光子与共封装光学（CPO）的先进封装技术》	<581>《面向无空洞填充的 TSV 铜电镀工艺建模与优化》	<450>《基于 NaOH 湿化学活化的 SiCN 介质键合》
	/	/	<474>《考虑 PCB 组装工艺与冲击尾波的扇出型 BGA 芯片板级跌落可靠性实验与数值研究》	<619>《用于 TGV 金属化的热应力缓解缓冲层研究及性能探究》
18:30-21:00	欢迎晚宴·由爱发科（ULVAC）赞助			
专题	会场 5	会场 6	会场 7	会场 8
	专题13	专题14	专题15	专题16
委员会	先进封装前沿技术	柔性电子前沿技术	基板材料与热机械性能	烧结材料与工艺
	专题 10-1-新兴领域封装	专题 10-2-新兴领域封装	专题 2-3-封装材料与工艺	专题 2-4-封装材料与工艺
主席	田艳红，哈尔滨工业大学	江哲，哈尔滨工业大学（深圳）	李力一，东南大学	李财富，中山大学
	于大全，厦门大学	丁苏，江南大学	张亮，厦门理工学院	陈传彤，日本大阪大学
15:50-16:15 特邀报告	《AI 借力面板级封装与玻璃基板，助推先进封装产业升级》	《液-固针料共存下 Sn 基微凸点焊点的电迁移行为》	《面向智能时代的三维异质集成 DRAM》	《从溶剂调控到智能设计与优化：烧结互连材料的多尺度研究》
	陈奕仪 博士，法国 Yole 集团，首席市场与技术分析师	岳武 教授，兰州工业学院 院长	拜福君 博士，西安紫光国芯半导体股份有限公司 高级总监	刘盼 博士，复旦大学 副教授
16:15-18:00 口头报告	<85>《面向星载电子的 Kovar 柱阵列三维气密堆叠封装结构》	<67>《用于柔性电子高效热管理的静电纺丝可拉伸 BNNS/PVA 复合薄膜》	<329>《各向异性组元协同增强的 AlN 纤维复合基板：兼具高弯曲强度与高热导率》	<117>《压接式 IGBT 封装大面积铜烧结性能优化》
	<121>《预干燥对低压烧结微米银接头显微组织与剪切强度的影响》	<276>《面向先进热管理与可靠封装的自修复辐射制冷电子皮肤》	<482>《考虑完整封装流程与底部填充材料性能的 BGA 芯片热翘曲仿真》	<561>《湿和一锅水相法制备铜微纳颗粒浆料及其低温空气烧结芯片粘接性能》
	<278>《兼容 2.5D 超量子计算架构的铜铝铜柱倒装互连方案》	<327>《基于金属还原构筑氧化石墨烯薄膜的自供能柔性湿度传感器》	<715>《先芯片与后芯片 FOWLP 异构集成的翘曲对比研究》	<43>《聚乙二醇分子量为无压银烧结浆料芯片粘接性能的影响》
	<406>《离子液体介导化学焊接实现钙钛矿单晶单片集成的通用策略》	<344>《用于含盖草动作电位检测的无创柔性电子传感技术实验研究》	<517>《硅通孔（TSV）聚合物填充工艺对比研究》	<641>《烧结银在海水环境中的腐蚀行为》
	<478>《用于硅桥定位的光刻胶热回流初步研究》	<465>《面向电子封装强化热管理的三维交联 PEG 基复合相变材料》	<491>《采用胶贴键合的三维铜箔基板精准气密封装技术》	<179>《Cu 薄膜微观组织对 Cu-Cu 键合性能的影响：晶粒生长动力学驱动的界面消除》
	<627>《嵌入式玻璃扇出封装工艺开发及应力与翘曲抑制》	<564>《用于印刷电子的高导电高粘附半烧结铜浆料》	<676>《集成 HBM 的 2.5D CoWoS 高密度多芯片模块制备与关键工艺优化》	<205>《面向下一代互连的加压铜烧结浆料开发》
	<760>《SAC305-xIn 焊球中 β-Sn 析晶形成调控：锡含量与冷却速率的影响》	<701>《静电打印技术在具身智能柔性传感器中的应用》	<31>HDQEP 封装角引线引脚改善研究	<741>《水相还原一锅法可控制备铜纳米球及其在 SiC 模块封装中的应用》
	<315>《铜纳米颗粒粒径相关烧结行为的分子动力学模拟研究》	/	/	/
18:30-21:00	欢迎晚宴·由爱发科（ULVAC）赞助			



8月7日 上午 --- 技术专题

专题	会场1	会场2	会场3	会场4
	专题17	专题18	专题19	专题20
委员会	CPO研讨会	ICEPT-ICEP 联合专场	光电子与热管理协同封装	热机械耦合建模（二）
主席	/	/	专题1-3. 先进封装	专题 3.3. 封装设计与建模
8:30-8:55 特邀报告	Farhang Yacobi, BroadPak Corp. 王启东, 中国科学院微电子研究所	森川泰弘, 日本爱发科株式会社 王俊沙, 日本明星大学	马盛林, 厦门大学 张艳, 北京大学	王曙, 复旦大学 史洪滨, 上海文为电子技术股份有限公司
	<8:40-8:55>《光子封装》 陈奕仪 博士, Yale 首席市场与技术分析师	《Cu浆料在先进半导体以及功率半导体键合中的研究》 陈传彬 教授, 日本大阪大学	《由输入方：北方华创助力板级封装行业发展》	《通过先进仿真技术攻克3D-IC设计挑战》
8:55-10:10 口头报告	《先进有机基板赋能规模化共封装光学》 Buda WANG 先生, AT&S TDI 总监	《基于原子层沉积（ALD）的先进封装薄膜应用》 李子豪 先生, 日本国际电气株式会社 工艺工程师	王 阳 先生, 北京北方华创真空技术有限公司 副总裁、PLP 事业单元总经理	侯明刚 先生, 新思科技 首席工程师
	《支撑共封装光学的材料技术：电光混合集成的挑战与解决方案》 Youshan Murokani 博士, 力森诺利集团 高级总监	《高效散热应用复合材料研究》 许斌 先生, 日本东京大学 讲师	<206>《面向 AI 计算中心网络互连 3.2T 光模块的 NPO 翘曲优化》	<617>《金属泡沫增强相变复合材料的传热与相变特性》
	《赋能新一代封装基板与共封装光学（CPO）的创新材料》 Habib Hicri 先生, 味之素得细科技（美国）有限公司 执行副总裁、高级研究员	《用于3D先进封装的晶圆临时键合/解键合的胶带方案》 沈伟强 先生, 积水（上海）国际贸易有限公司 销售主管	<291>《面向先进封装热点抑制的纳米互连热导率表征》	<673>《GaN/AlN 异质结构界面热阻的温度依赖性：近界面区 GaN 空位的作用》
	圆桌讨论		<303>《基于预成核辅助冰模法的局部热点定向冷却》	<680>《面向三维集成电路的圆柱针肋嵌入式微通道热机械耦合分析与可靠性优化》
			《半导体封装基板与高密度互联的工艺挑战与失效性分析》	<730>《高散热倒装芯片 SIP T/R 模块设计与分析》
			魏文静 女士, 赛特新科技（重庆）有限公司 实验室经理	<318>《含硅桥与 TMV 的密封晶圆翘曲仿真》
10:10-10:50	海报展示 B			
专题	会场5	会场6	会场7	会场8
	专题21	专题22	专题23	专题24
委员会	AI 赋能封装热管理	工艺与设计优化	射频封装	制造工艺与互连
主席	专题 11-1-AI 赋能的先进封装	专题 6-2. 质量与可靠性	专题 9. 射频电子封装	专题 5-2. 先进制造
8:30-8:55 特邀报告	孙宏滨, 西安交通大学 王成, 上海交通大学	杨晓伟, 工业和信息化部电子第五研究所 李迪, 北京航天微系统与信息技术研究所	王楠, 上海大学 孙博, 广东工业大学	张淑黎, 中国科学院微电子研究所 阙水保, 合肥工业大学
	《封装微系统的瞬态辐射效应》	《微系统互联结构失效机理与可靠性评估技术》	《面向高效毫米波 NTN 应用的 Q-band 4×4 相控阵封装天线（AP）》	《用于功率电子封装的先进芯片封装技术》
8:55-10:10 口头报告	张园和 教授, 中国西安交通大学 微电子学院副院长	李凌 博士, 中国西安微电子技术研究所 副总工程师	沈昱正 博士, 中国台湾环旭电子股份有限公司 高级副总裁	刘刚 博士, 荷兰代尔夫特理工大学 玛丽·居里学者
	<34>《SiC 功率模块封装热-机械性能数字化优化框架》	<93>《整机级跌落试验中设计参数对封装开裂失效机制的影响》	<10>《基于三维金属微同轴技术与 SiP 集成的高集成度 D 波段太赫兹辐射器》	<126>《考虑热扰动的芯片热压键合力/位混合控制研究》
	<98>《FNOPlace: 傅里叶神经网络加速的 2.5D 封装热感知 Chiplet 布局方法》	<102>《LQFP 10×10 双芯片封装分层失效分析与改善》	<325>《考虑制造公差 AI 辅助 Ku 波段双极化 AiP 天线稳健设计》	<494>《基于铜箔压印的高可靠嵌入式线路制备方法》
	<435>《物理信息与 POD 引导的稀疏温度场重构深度学习框架》	<221>《先进封装基板盲孔纳米空洞的形成机制与改善方法》	<744>《基于柱阵列的稀疏矩形波导带通滤波器》	<479>《混合尺寸铜纳米线阵列增强低温 Cu-Cu 键合》
	<515>《基于改进多保真贝叶斯优化的 2.5D 异构系统热感知 Chiplet 高效布局》	<245>《免清洗工艺中底部填充材料性能对倒装芯片可靠性的影响》	<731>《2.4 GHz 薄膜体声波谐振器滤波器的晶圆级薄膜封装》	<90>《多路微流控系统同轴三维打印互连的快速规模化制备》
10:10-10:50	<686>《2.5D Chiplet 封装 RDL 正交各向异性热膨胀系数快速预测》	<588>《Chiplet 集成中 PECVD 二氧化硅间隙填充裂纹形成机制》	<626>《面向宽带射频应用的自感抵消三维片上集成电容》	<733>《扇出型晶圆级封装气体分布板结构优化及等离子体光刻胶去除提升的仿真与实验验证》
10:10-10:50	海报展示 B			



8月7日 上午 --- 技术专题

专题	会场1 专题25 CPO研讨会 /	会场2 专题26 功率器件与模块设计及应用 专题 7.2-功率电子与能源电子	会场3 专题27 异质集成工艺材料 专题 2.5-封装材料与工艺	会场4 专题28 封装优化建模与分析 专题 3.4-封装设计与建模
委员会				
主席	Rohang Tandon , BroadFok Corp 王启东, 中国科学院微电子研究所	侯召政, 华为数字能源技术有限公司 杨孝涛, 西安交通大学	刘志权, 南方科技大学 刘刚, 代尔夫特理工大学	陈沛, 北京工业大学 苏梅英, 中国科学院微电子研究所
10:50-11:15 特邀报告	<10-55-11:10> 《突破激光器瓶颈: DFB 激光器用量直降 60 倍, 简化共封装光学量产工艺》 Pirooz Hajabri 先生, IC Photonics 总裁 《面向先进共封装光学、线性能量光模块、近封装光学与光电路交换的智能制造解决方案》 Alex CAO 先生, JfeonTEC 中国区总经理 《面向规模化量产的共封装光学器件热-力学性能挑战与机遇》 Shan Fang Wang 博士, 英特尔首席工程师兼工程总监 圆桌讨论	《基于金属化光纤电阻焊技术的 10Gbps 空间平衡探测器研究》	《超大尺寸 Chiplet 先进封装的工艺材料挑战及解决方案》	《机器学习模型在封装可靠性分析中的高级应用》
		马贞 女士, 空间电子技术研究院 制造中心副主任	史洪宾 博士, 艾为电子技术股份有限公司 芯片封装首席专家	Karsten Meier 博士, 德国德累斯顿工业大学 高级研究员、助理主任
11:15-12:30 口头报告		<125> 《面向低压配电应用的 1200 V SiC MOSFET 可靠性评估与多应力寿命建模》	《先进封装基板玻璃的机遇与挑战》 张海鹏 博士, 山东力诺医药包装股份有限公司 研发总监	<343> 《表面形貌对 SiC 功率芯片铝线键合界面可靠性的影响》
		<13> 《考虑相位重叠效应的多相 Buck 变换器—单相等效电路》	<481> 《车载高压器件环氧塑料开发中的关键挑战》	<393> 《采用三维互感抵消结构的低寄生电感双面冷却 SiC 功率模块》
		<50> 《关节模组控制器的低压逆变器多功能集成系统级封装》	<201> 《先进电子封装底部填充材料中机械支撑与热应力管理的协同平衡》	<444> 《用于 IMC 层裂演化分析的热机械耦合 TPF-CZM 模型》
		<330> 《提升功率模块热管理稳定性的热电制冷主动温控系统》	<374> 《用于 PCBA 板级 EMI 共形屏蔽封装的可逆粘附电磁屏蔽膜》	<335> 《电-热-机械耦合载而下 Sn37Pb 焊料的疲劳寿命》
	<523> 《无需热与机械工艺的功率电子芯片返修技术》	<742> 《面向高性能热界面材料的聚离子液体/银-液态金属复合材料设计》	<471> 《面向可靠性的低成本板级封装 (PLP) 设计优化》	
12:30-13:30	午餐			
专题	会场5 专题21 AI 赋能封装热管理 专题 11-1-AI 赋能的先进封装	会场6 专题22 工艺与设计优化 专题 6-2-质量与可靠性	会场7 专题23 射频封装 专题 9-射频电子封装	会场8 专题24 制造工艺与互连 专题 5-2-先进制造
委员会				
主席	孙宏滨, 西安交通大学 王成, 上海交通大学	杨健伟, 工业和信息化部电子第五研究所 李迪, 北京航空航天大学微系统与信息技术研究所	王楠, 上海大学 孙博, 广东工业大学	张淑黎, 中国科学院微电子研究所 戴水保, 合肥工业大学
10:50-11:15 特邀报告	《封装微系统的瞬态辐射效应》	《微系统互联结构失效机理与可靠性评估技术》	《面向高效率毫米波 NTN 应用的 Q-band 4×4 相控阵封装天线 (AP) 》	《用于功率电子封装的先进芯片封装技术》
	张国和 教授, 中国西安交通大学 微电子学院副院长	李凌 博士, 中国西安微电子技术研究所 副总工程师	沈星正 博士, 中国台湾环旭电子股份有限公司 高级副总裁	刘刚 博士, 荷兰代尔夫特理工大学 玛丽·居里学者
11:15-12:30 口头报告	<34> 《SiC 功率模块封装热-机械性能数字化优化框架》	<93> 《整机级跌落试验中设计参数对封装开裂失效机制的影响》	<10> 《基于三维金属微同轴技术与 SiP 集成的高集成度 D 波段太赫兹辐射器》	<126> 《考虑热扰动的芯片热键合力/位混合控制研究》
	<98> 《FNOPlace: 傅里叶神经网络加速的 2.5D 封装热感知 Chiplet 布局方法》	<102> 《LQFP 10×10 双芯片封装分层失效分析与改善》	<325> 《考虑制造公差 AI 辅助 Ku 波段双极化 AP 天线稳健设计》	<494> 《基于铜箔压印的高可靠嵌入式电路制备方法》
	<435> 《物理信息与 POD 引导的稀疏温度场重构深度学习框架》	<221> 《先进封装基板盲孔纳米空洞的形成机制与改善方法》	<744> 《基于柱阵列的消逝模矩形波导带通滤波器》	<479> 《混合尺寸铜纳米线阵列增强低温 Cu-Cu 键合》
	<515> 《基于改进多保真贝叶斯优化的 2.5D 异构系统热感知 Chiplet 高效布局》	<245> 《免清洗工艺中底部填充材料性能对倒装芯片可靠性的影响》	<731> 《2.4 GHz 薄膜体声波谐振器滤波器的晶圆级薄膜封装》	<90> 《多路微流控系统同轴三维打印互连的快速规模化制备》
	<686> 《2.5D Chiplet 封装 RDL 正交各向异性热膨胀系数快速预测》	<588> 《Chiplet 集成中 PECVD 二氧化硅间隙填充裂纹形成机制》	<626> 《面向宽带射频应用的自感抵消三维片上集成电容》	<733> 《扇出型面板级封装气分布板结构优化及等离子体光刻胶去除提升的仿真与实验验证》
12:30-13:30	午餐			



8月7日 下午 --- 大会报告	
主席	刘建影 教授，瑞典皇家工程科学院院士
13:30-14:00	《面向 Chiplet 的整体封装解决方案》
	Tanja Braun 博士，德国弗劳恩霍夫可靠性和微集成研究所 部门主任
14:00-14:30	《协同创新，驱动先进封装材料革新》
	Hidenori ABE 先生，日本力森诺科株式会社 电子事业总部 执行董事、半导体材料首席技术官
14:30-15:00	《先进封装设备赋能异构集成新生态》
	余飞 先生，中国北京北方华创微电子装备有限公司 市场产品解决方案总监
15:00-15:30	《晶圆键合在先进封装中的应用》
	蔡维伽 先生，中国吾拾微电子（苏州）有限公司 首席技术官
15:30-16:10	墙报展示 C
主席	刘志权 教授，中国南方科技大学
16:10-16:40	《蓄势待发，迎接硅光挑战》
	严然 博士，中国广州增芯科技有限公司 全球商务中心副总裁
16:40-17:10	《Chips Z: 2.5D/3D AI EDA+ 引领 STCO 驱动的系统级协同设计新时代》
	赵毅 博士，中国珠海硅芯科技有限公司 创始人兼首席科学家
17:10-17:40	《半导体产业：晶圆制造设备、配套工艺及关键材料对先进封装的影响》
	Kitty Pearsall 博士，EPS 杰出讲师，EPS 前主席，IEEE Fellow
17:40-18:10	《人工智能、政治与工程碰撞下的电子制造业重塑之路！》
	Charles Bauer 博士，美国 TechLead Corporation 高级董事总经理
18:30-20:00	闭幕晚宴（仅限受邀人员）



张贴报告分布图

张贴报告分布图													
张贴报告 A													
2026年8月6日 星期四, 15:10-15:50													
1区		2区		3区		4区		5区		6区		7区	
专题 1 先进封装		专题 2 封装材料与工艺		专题 2 封装材料与工艺		专题 3 封装设计与建模		专题 4 互连技术		专题 3 封装设计与建模		专题 6 质量与可靠性	
专题 7 功率电子与能源电子		专题 11 AI 赋能的先进封装		专题 10 新兴领域封装		专题 5 先进制造		专题 8 光电子与显示技术		专题 9 射频电子封装		专题 6 质量与可靠性	
17, 45, 54, 62, 123, 124, 131, 134	53, 60, 82, 149, 195, 225	8, 35, 55, 118, 119, 122, 137, 138, 769	66, 84, 169, 172, 227, 242	148, 154, 187, 199, 208, 209	18, 41, 58, 88, 127, 182, 272	15, 25, 103, 130, 181, 189, 202, 220	22, 51, 191, 211, 247, 271	26, 52, 64, 76, 95, 97, 129, 133, 151, 177	69, 144, 241, 307	238, 248, 250, 255, 283, 289, 299	63, 96, 192, 193	83, 89, 105, 147, 150, 161, 171, 204, 216, 237, 244, 252, 257, 258, 262, 263	136, 156, 157, 163, 207, 253
9, 11, 29, 32, 39, 42, 44, 47, 48, 73													
张贴报告 B													
2026年8月7日 星期五, 10:10-10:50													
专题 1 先进封装		专题 2 封装材料与工艺		专题 2 封装材料与工艺		专题 3 封装设计与建模		专题 4 互连技术		专题 3 封装设计与建模		专题 6 质量与可靠性	
专题 7 功率电子与能源电子		专题 11 AI 赋能的先进封装		专题 10 新兴领域封装		专题 5 先进制造		专题 8 光电子与显示技术		专题 9 射频电子封装		专题 6 质量与可靠性	
290, 316, 324, 341, 356, 358	226, 264, 292, 382	217, 218, 230, 235, 240, 246, 251, 260, 268, 270	323, 391, 400, 452	279, 293, 308, 340, 377, 667, 672, 691, 715, 720	328, 405, 419, 424, 438, 505, 518, 579	320, 350, 369, 370, 386, 417, 475	282, 314, 359, 366, 367, 384	198, 219, 285, 322, 333, 372, 392, 397, 401, 433	321, 362, 432, 757	492, 495, 496, 509, 510, 514, 520, 534, 540, 553	345, 446	269, 284, 287, 309, 311, 349, 352, 353, 360, 375, 376, 388, 413, 414, 430, 436	415, 420, 489, 529, 544, 584
439, 443, 456, 466, 477, 480, 486, 504													
张贴报告 C													
2026年8月7日, 15:30-16:10													
专题 1 先进封装		专题 2 封装材料与工艺		专题 2 封装材料与工艺		专题 3 封装设计与建模		专题 4 互连技术		专题 3 封装设计与建模		专题 6 质量与可靠性	
专题 7 功率电子与能源电子		专题 11 AI 赋能的先进封装		专题 10 新兴领域封装		专题 5 先进制造		专题 9 射频电子封装		专题 6 质量与可靠性		专题 1 先进封装	
600, 646, 650, 659	498, 558, 604, 653, 736, 754	383, 389, 396, 412, 425, 431, 457, 462, 467, 468, 487, 522	497, 551, 644, 690	526, 535, 545, 555, 560, 562, 563, 571, 606, 609, 611, 623	620, 621, 662, 694, 710	559, 568, 575, 594, 632, 665, 770	408, 484, 689, 702, 722, 723, 734	493, 502, 554, 566, 572, 595, 613, 622, 628, 631, 633, 640, 664, 721, 724, 755	670, 706, 719, 761	530, 636, 657	556, 567, 578, 580, 583, 591, 593, 608, 614, 616, 625, 630, 645, 654, 655, 656	660, 669, 708, 767, 768	658, 666, 668, 695, 700, 703, 729, 732, 737, 745, 746, 747, 750



注册报名

点击 <https://event.mymova.com/spa6/#/?eventname=icept&lang=en>

或者扫描二维码进行报名:



如有疑问或其他建议, 请联系:

王晓楠: +86-13121110782; support@fsemi.tech

王思懿: +86-19844989610; siyi.wang@fsemi.tech

会议注册类型	项目	提前注册 (截至2026年7月7日)	常规注册 (自2026年7月8日起)
IEEE会员	参会者 (全程会议+PDC专业发展课程培训)	2,880元	2,880元
	参会者 (全程会议)	2,700元	2,700元
非IEEE会员	参会者 (全程会议+PDC专业发展课程培训)	2,880元	3,200元
	参会者 (全程会议)	2,700元	3,000元
学生	学生 (全程会议+PDC专业发展课程培训)	2,160元	2,400元
	学生 (全程会议)	1,980元	2,200元
*取消政策: 如您无法参会, 可将会议名额转让给他人。如需取消注册, 将收取300元的取消费用。			
公司名称:	北京恒仁致信咨询有限公司		
开户行:	招商银行股份有限公司北京北三环支行		
账号:	110948838510901		
地址:	北京市朝阳区阜通东大街1号院5号楼2单元26层2605室		